

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于德赛矽镨签订 SIP 封装产业项目投资建设协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了推进落实公司的战略规划，加快公司 SIP（System In a Package，系统级封装；以下简称 SIP）业务的发展，公司全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称“德赛矽镨”）于 2022 年 2 月 21 日在广东惠州仲恺高新区与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订了《德赛矽镨 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》，在惠州仲恺（国家级）高新技术产业开发区（以下简称：仲恺高新区）辖区范围内投资建设 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目。项目计划投资总额约为 21 亿元，其中固定资产投资总额不低于 15 亿元。

二、相关投资决策程序

2022 年 2 月 21 日，公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于德赛矽镨签订 SIP 封装产业项目投资建设协议书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

三、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会
- 2、性质：地方政府机构
- 3、住所：广东省惠州市仲恺高新区仲恺大道(惠环段)666 号
- 4、关联关系：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、协议书的主要内容

（一）协议双方当事人

甲方：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会

乙方：广东德赛矽镨技术有限公司

（二）协议主要内容

1、项目名称：协议书所称的项目是指乙方投资建设的德赛矽镨 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目（以下简称：项目），项目建成后主要生产经营电子元器件制造。

2、项目用地：项目使用土地的性质为工业用地，土地使用权出让年限为 50 年，意向选址位于仲恺高新区内 ZKD-002-104-01 地块。乙方拟在上述地块建设及经营本项目。项目建设用地面积约 88,984 平方米（以市自然资源局实际挂牌出让面积为准），土地挂牌价格以实际评估价为准。

3、投资规模：项目计划投资总额约 21 亿元，固定资产投资总额不低于 15 亿元，总容积率不低于 1.6，总建筑面积约 142,400 平方米。项目全部建成并达产后十年内，预计实现年销售收入 50 亿元，实现年纳税总额 1.1 亿元。

4、开发建设周期：乙方按项目一次性供地、一次性统一开发方式进行建设。乙方在甲方交付土地后（自签署《“净地交付”联合验收登记表》之日起计，下同）的 30 日内启动项目建设前期相关准备工作；乙方在甲方交付土地后的 3 个月内实质性进场动工（动工是指地勘进场），30 个月内整体竣工、36 个月内投产、39 个月内产值上规纳统、投产后 2 年内达产。乙方须按照上述约定时间及投资计划进行项目的投资建设及投产运营。对于以上约定，如因乙方原因导致项目推进流程可能延误时，乙方须提前书面告知甲方并取得甲方的书面同意。

5、甲方主要权责

（1）甲方在土地具备出让条件时，依法挂牌出让项目建设用地使用权。

（2）如乙方依法取得土地使用权，项目建设用地按照“四通一平”（即道路、供水、供电、排水、场地平整）的净地标准 30 日内交付乙方使用。

（3）如乙方依法取得土地使用权，甲方应积极协助乙方办理《不动产权证书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》等相关手续。

（4）如乙方遇到项目的建设及经营涉及到甲方的业务时，在乙方向甲方提出诉求后，甲方应积极协调并妥善解决。甲方提供相关的投资服务和公共管理，指导和协助乙方开展相关工作，协调解决乙方在项目建设及经营过程中遇到涉及甲方的问题困难。

（5）甲方鼓励乙方积极开展科技创新，在乙方符合国家、省、市和仲恺高新区等的重点建设项目、科技创新项目等条件下，可协助乙方申报“高新技术企业”、“创新型企业”和“重点项目”等认定，甲方协助乙方申请国家、省、市优惠政策支持。

6、乙方主要权责

(1) 乙方按照国家规定的土地出让挂牌竞标程序合法取得项目建设用地使用权。按照《土地成交确认书》及缴费通知要求足额支付土地价款及相关税费，与惠州市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

(2) 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定（建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设），乙方在开工建设前必须取得环保主管部门对该投资项目的环评影响评价文件的审批，以及提交水土保持方案。

(3) 乙方在建设和生产经营期间内应当遵守国家法律法规和甲方的相关规定，保证文明施工和安全生产。乙方有义务按照惠州市住建局《关于切实加强建设工程施工施工现场密目式安全立网和施工围挡使用管理的通知》（惠市住建函[2019]1135号）文件精神加强建筑工地施工围挡使用管理。

(4) 乙方在甲方区域内的一切活动不得损害或破坏周边设施及环境，不得恶意超标排放或违规偷排污染物，如造成国家或他人损失的，乙方须承担相应的责任。

(5) 乙方将项目建设过程纳入“仲恺高新区工业用地项目全生命周期跟进服务系统”管理，并积极配合提供相关经济运行数据，以方便甲方做好项目全过程管理和服务工作。

(6) 签订本协议后，若乙方控股权发生变更，则乙方须在完成工商变更后一个月内书面告知甲方，且乙方股权变更事项不得影响本协议的履行。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次德赛矽镨投资建设 SIP 封装产业项目是为了推进落实公司的战略规划，促进公司 SIP 业务更好更快发展，进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力。

2、本次投资存在的风险

(1) 本项目投资建设协议书的签署尚需公司股东大会审议通过，本次项目投资建设协议书是否生效存在不确定性。

(2) 本次投资涉及的项目用地尚未取得，需通过参与招拍挂程序依法取得项目用地的土地使用权，公司将积极参与政府的土地招拍挂公开程序，但竞拍结果具有不确定性。

(3) 如国家或地方有关政策调整、宏观经济影响等带来项目实施条件因素发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在变更、顺延、中止或者终止的风险。

(4) 本投资建设协议书涉及的预计年销售收入、年纳税总额等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺；

项目收益受宏观经济、市场波动、项目进度等因素的影响，存在不确定性，且存在最终金额与协议金额不一致的风险。

（5）本项目资金来源为公司自有及自筹资金，本项目的投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

3、本次交易对公司的影响

本次德赛矽镨签署项目投资建设协议书事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，投资建设 SIP 产业项目对公司 SIP 业务的未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《第十届董事会第八次（临时）会议决议》
- 2、《德赛矽镨 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日